



符合 SFF-TA-1002 的 Sliver 解决方案

TE 内部编号 2297117-2

PCB Edge Card, Vertical, Cable-to-Board, 148 Position, Surface Mount, .6 mm [.023 in] Centerline, Sliver for SFF-TA-1002, Internal I/O Connectors

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 内部 I/O 连接器



连接器接合对象: PCB 卡边缘

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 缆到板

位数: 148

PCB 端接方法: 表面贴装

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器接合对象	PCB 卡边缘
连接器系统	缆到板

结构特性

行数	2
PCB 安装方向	垂直
位数	148

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子底板材料	镍
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	铜合金
端子额定电流 (最大值)	.9 A
端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]



端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	.6 mm[.023 in]
---------	----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

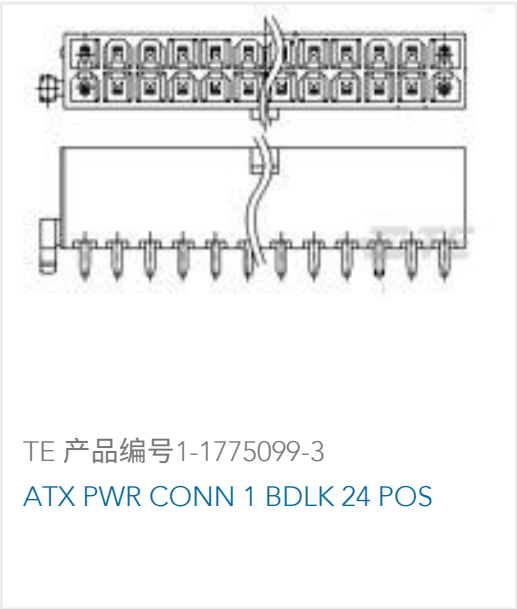
配套部件



该系列中的其他产品 | 符合 SFF-TA-1002 的 Sliver 解决方案



客户还购买了



文档

产品图纸
RCPT CONN VERT 148 POSN MBC
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D

下载查看
ENG_CVM_CVM_2297117-2_1.2d_dxf.zip
英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_2297117-2_1.3d_igs.zip
英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_2297117-2_1.3d_stp.zip



英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Sliver Internal Cabled Interconnect Solutions Brochure \(Chinese\)](#)

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本